

## Thermaltake Level 10 GTS



**LINK (<https://www.nexthardware.com/recensioni/case/693/thermaltake-level-10-gts.htm>)**

Dimensioni ridotte e prezzo contenuto per un case robusto e versatile con il solito inimitabile design che ha reso celebre la serie di appartenenza ...

Se durante il Cebit 2009 Thermaltake lasciò il segno con la presentazione del **Level 10**,↔ frutto della collaborazione con il dinamico **BMW Group Designworks USA** ispirato e diretto dal celebre designer **Chris Bangle**, nessuno si sarebbe aspettato, in un settore che brucia letteralmente ogni innovazione nel giro di pochi mesi (a volte settimane), che tale opera di ingegno, perchè risulta evidente non si tratti solo di un case, potesse continuare a dare i suoi frutti a distanza di ben tre anni.

Non a caso, sostituiti i circa 22 kg di nobile Alluminio con materiali come plastica ed acciaio, ridimensionati gli ingombri, aggiornato lo standard delle connessioni e, ovviamente, umanizzato il prezzo, il naturale successore, ovvero il Level 10 GT, ha ottenuto il consenso di stampa ed utenza (in particolare quella gaming) generando ottimi volumi di vendita sin dal lancio.

A quest'ultimo sino sono aggiunte nel tempo versioni più economiche per andare incontro ad un parco di potenziali clienti ancora più vasto grazie ad una rivisitazione del progetto originale, senza per questo snaturarne il design e penalizzarne le funzionalità offerte.

In questa recensione andremo ad analizzare l'ultimo nato della fortunata serie, il **Level 10 GTS**, un Mid Tower realizzato mediante una struttura in acciaio SECC con 0.7mm di spessore ed un profilo frontale in solida plastica.

Il Thermaltake Level 10 GTS↔ è in grado di ospitare schede madri in formato ATX e Micro-ATX e configurazioni multi VGA NVIDIA 2-Way SLI e AMD CrossFireX.

La gestione degli spazi interni, inoltre, è stata studiata per permettere un veloce assemblaggio ed una facile manutenzione del sistema.

Le soluzioni utilizzate sono le più recenti ed innovative: sono presenti, infatti, una predisposizione per sistemi di watercooling, numerosi filtri antipolvere removibili, due connessioni USB 3.0 con plug 20pin per un collegamento diretto all'header della motherboard, nonchè un sistema hot-swap per HDD e SSD sia da 3,5" che 2,5".

Ma andiamo ora ad elencare in dettaglio le versioni disponibili, le caratteristiche principali e la scheda tecnica del modello in recensione.

## Versioni disponibili

- Thermaltake Level 10 GTS↔
  - ↔ Thermaltake Level 10 GTS Snow↔ Edition
- ↔

## Caratteristiche principali

- Solida Struttura realizzata in SECC e solida plastica.
- Sistema di fissaggio dei drive ottici e schede PCI in modalità tool-less.
- Filtri per evitare l'accumulo della polvere.
- Connessione USB 3.0 sull'I/O Panel tramite plug 20pin.
- Cable Management ottimale grazie agli scassi distribuiti sul vassoio della motherboard.
- Ampio inserto per la rapida installazione di un dissipatore aftermarket.

↔

## Scheda tecnica↔ ↔

↔ Marca	Thermaltake (Taiwan)
↔ Modello	Level 10 GTS
↔ Materiali utilizzati	Plastica per la parte frontale - Top e corpo in acciaio SECC da 0,7 mm
↔ Supporto Motherboard	↔ Standard ATX e microATX
↔ Alloggiamenti Drive presenti	Esterni 5.25" x 4 e 3.5" x 1 Interni 3.5"/2.5 x 1 + Hot-Swap 3.5"/2.5" x 4
↔ Sistema di raffreddamento (ventole)	Frontale 1 x 200mm (bundle) ↔ Posteriore 1 x 120mm (bundle) Top 1 x 200mm / 2 x 120mm (opzionali) Pannello Laterale 1 x 200mm / 1 x 140mm (opzionale) ↔ ↔ Interne 2 x 120mm↔ (opzionali)
↔ Docking Station	No
↔ Slot di espansione	8
↔ Connessioni I/O frontali	USB3.0 x 2 Audio x 1 MIC x 1
↔ Altezza massima dissipatore CPU	175mm
↔ Lunghezza massima VGA	315mm
↔ Dimensioni complessive	233mm(W) x 462mm(H) x 510mm(D)
↔ Peso	6.8 kg

↔

↔

## 1. Packaging & Bundle

### 1. Packaging & Bundle

↔

#### Packaging



↔

La confezione è realizzata in solido cartone e presenta una grafica aggressiva per entrambe i lati principali con l'immagine del case ripreso da un'angolazione di 45↔°.

La scelta dei colori non è casuale, infatti Thermaltake ha deciso di usare come colori predominanti il nero e il rosso che ne caratterizzano da sempre l'immagine.

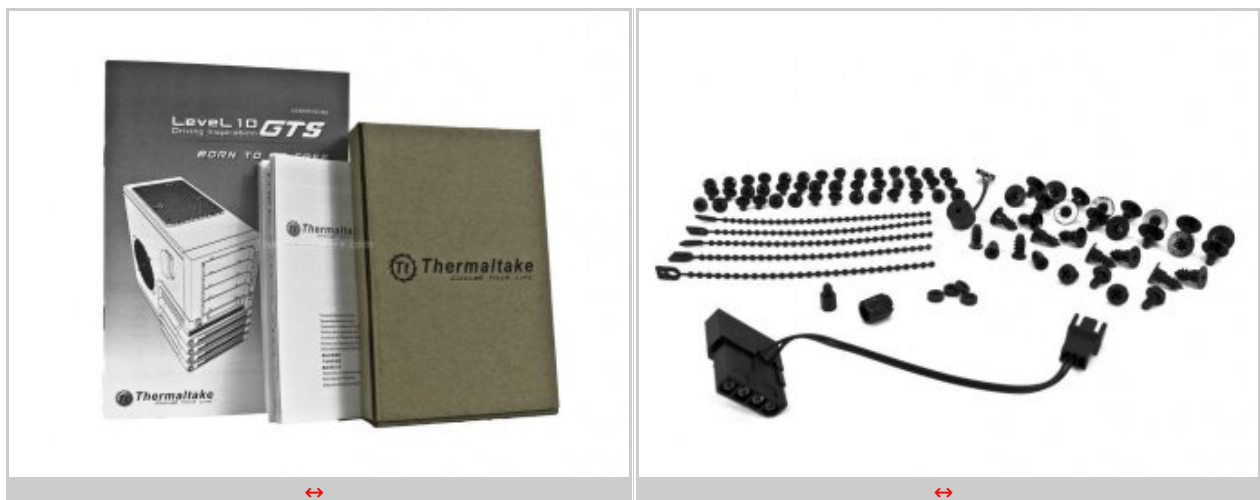
Su uno dei due lati corti troviamo le caratteristiche tecniche del prodotto tradotte in diverse lingue, tra cui anche l'italiano.

Sul lato rimanente, invece, sono presenti un'ulteriore immagine ed alcuni dettagli aggiuntivi come il peso a vuoto e con hardware installato.

↔

## Bundle

Il Bundle che accompagna il Level 10 GTS↔ è davvero importante, non tanto per l'originalità dei componenti, quanto piuttosto per la quantità.



↔

Nello specifico troviamo:

- Un Flyer contenente le istruzioni di assemblaggio del prodotto nelle lingue italiano, inglese, francese, tedesco, olandese, spagnolo, cinese e taiwanese.
- Una brochure che spiega il contratto di garanzia dell'azienda per i suoi prodotti.
- Cinque fascette per un migliore cable management del sistema, le quali si possono riutilizzare, visto che usano un sistema di bloccaggio di tipo sferico.
- Uno speaker audio.
- Un adattatore per alimentare una ventola via molex 4pin.
- Tre sacchetti contenenti i distanziali e la viteria che consente di far fronte a qualsiasi esigenza durante le operazioni di assemblaggio.

↔

↔

## 2. Out of the Box

## 2. Out of the Box

↔



↔

Aperto la confezione↔ notiamo che il Thermaltake Level 10 GTS è protetto dagli urti da due semigusci di polistirolo e da un rivestimento in tessuto per evitare graffi accidentali.

↔

### Viste Laterali



↔

I pannelli laterali sono realizzati entrambi in acciaio SECC con una verniciatura di colore nero opaco.

Quello di sinistra è predisposto per ospitare una ventola da 140 o 200mm e consente di alloggiare un paio di cuffie su un apposito "gancio" che vedremo meglio in seguito.

Il pannello opposto ha una bombatura verso l'esterno in modo da guadagnare spazio e permettere di effettuare un miglior cable management a vantaggio del ricircolo dei flussi d'aria interni al case.

↔

### Viste con un angolo di rotazione di 45 gradi

---



↔

Quattro immagini con un angolo di rotazione di 45 gradi, che sottolineano il particolare design indirizzato al mondo del gaming del Thermaltake Level 10 GTS.

↔

### 3. Analisi esterna

### 3. Analisi esterna

↔

### Frontale

---



↔

Il frontale del Thermaltake Level 10 GTS è realizzato in solida plastica per consentire, tramite stampo, di riprodurre la caratteristica linea della famiglia di appartenenza senza incidere in modo significativo sul costo finale.

↔



↔

A dare quel tocco di classe alla parte anteriore del prodotto troviamo il logo dell'azienda riportato nel colore bianco.

Poco più in basso sono presenti quattro alloggiamenti per unità da 5.25", un quinta da 3.5" e, a lato, l'I/O Panel che è formato da due porte USB 3.0 per il trasferimento dei dati in modalità SuperSpeed, i jack per le cuffie ed il microfono, e due USB 2.0.

Nella parte inferiore, invece, è presente una ventola da 200mm dotata di LED blu, provvista di filtro antipolvere, deputata al raffreddamento delle unità di archiviazione installate negli speciali bay hot-swap posti dietro di essa.

↔

**Posteriore**

---



Sul retro del case, in alto, troviamo tre fori passatubo provvisti di guarnizione in gomma, che consentono l'installazione di un eventuale radiatore esterno; immediatamente al di sotto è presente una ventola da 120mm destinata ad espellere l'aria calda dal case.

Continuando a scendere incontriamo i sette bracket PCI a fianco dei quali ne è presente un altro, posto verticalmente, da usare per quei profili che ospitano porte USB, eSATA, molex o altre interfacce di connessione.

La zona più bassa è predisposta per ospitare l'alimentatore che verrà installato con la ventola rivolta verso il basso, in modo pescare aria fresca dall'esterno.



## Parte superiore

---



Dettaglio della predisposizione per le ventole presente sul top.

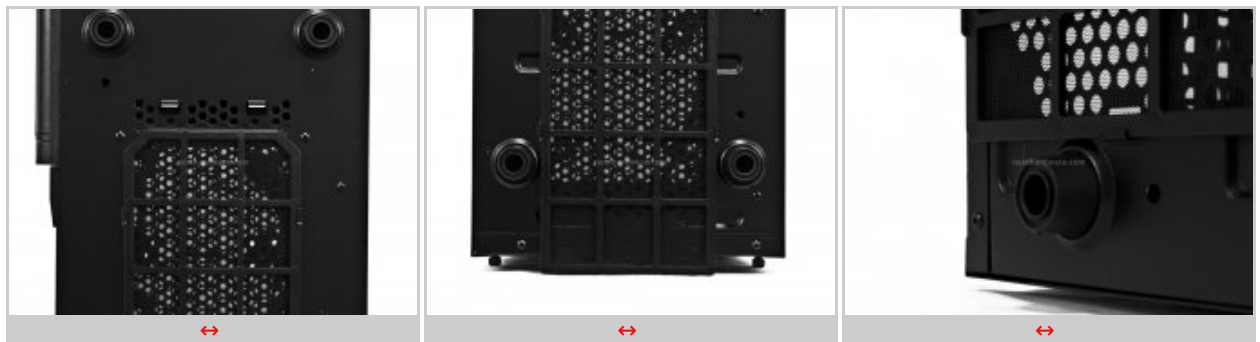


La parte superiore del cabinet è realizzata in acciaio SECC ed è caratterizzata da una mesh metallica che la percorre quasi interamente, al di sotto della quale possiamo installare, a piacimento, due ventole da 120mm o un'unica ventola da 200mm.

## Parte Inferiore

---





↔

La parte inferiore è caratterizzata da un ampio scasso, provvisto di filtro antipolvere, per consentire, come già accennato, il pescaggio di aria fresca da parte della ventola dell'alimentatore.

Questa specifica area, inoltre, consente l'installazione di un'ulteriore ventola da 120mm per migliorare i flussi d'aria in entrata nel cabinet.

I piedini sono realizzati in solida gomma e consentono di ridurre efficacemente le vibrazioni prodotte dall'intero sistema.

↔

↔

#### **4. Particolari esterni**

#### **4. Particolari esterni**

↔

Passiamo ad analizzare, ora, i particolari esterni del Thermaltake Level 10 GTS.

↔

#### **Profilo Posteriore**



↔

Nella parte posteriore alta del case è presente un anello nel quale infilare la chiave di apertura/chiusura del sistema hot-swap, evitando così di smarrirla una volta utilizzata.

### Profilo Frontale



↔

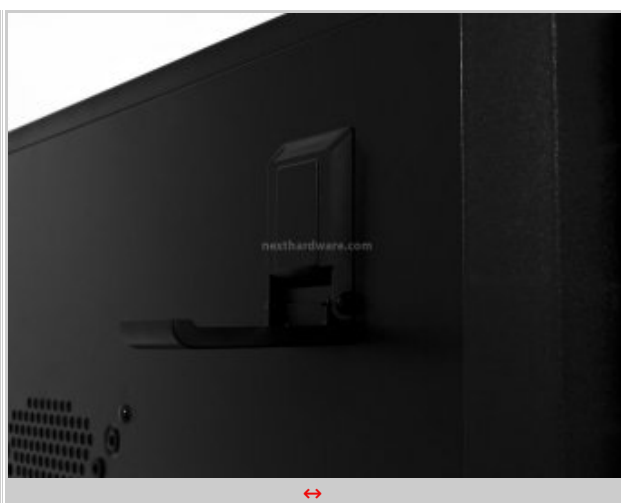
Il sistema di fissaggio delle unità di storage è gestito da una serratura e da un sistema a perni che permette un rapido accesso tramite la semplice pressione di un pulsante in corrispondenza della slitta prescelta.

↔

---



## Parte Laterale



↔

Un aspetto che sarà molto apprezzato, specialmente dai gamers, riguarda la possibilità di appoggiare le cuffie su di un gancio richiudibile costituito da un sistema a perno con profilo calamitato.

↔

## 5. Analisi interna

### 5. Analisi interna

↔

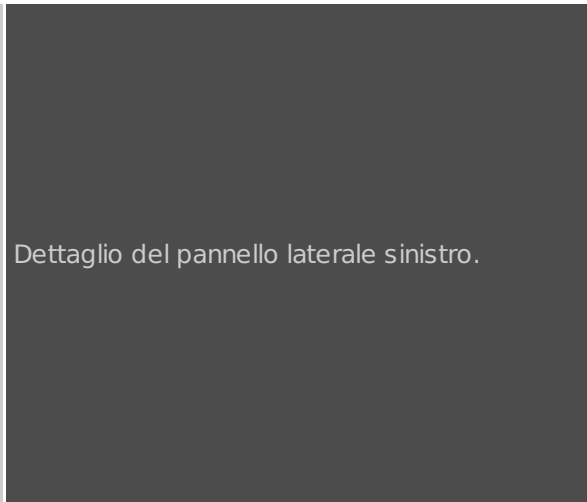


↔

Gli spazi interni consentono un assemblaggio semplice e veloce grazie anche alla predisposizione per VGA di ultima generazione, con ben 315 millimetri tra i bracket PCI e il cestello che ospita le slitte degli HDD/SSD.↔

Sul vassoio della scheda madre sono presenti le consuete asole passacavo con guarnizione in gomma ed un ampio scasso per l'installazione di un dissipatore aftermarket con un'altezza massima di 175mm.

Segnaliamo che il Thermaltake Level 10 GTS permette di montare motherboard in formato ATX e Micro-ATX, ma non E-ATX come molti dei prodotti concorrenti.



↔

Il pannello laterale, come già accennato in precedenza, consente di installare una ventola opzionale da 140 o 200mm per incrementare la ventilazione di una delle zone più critiche del case, ovvero quella degli slot PCI-Express.

↔

---



Il pannello frontale è facilmente rimovibile: basta premere sei inserti in plastica per separarlo dalla struttura del case.

Segnaliamo che, insieme a quest'ultimo, viene rimosso anche il filtro posto a protezione della ventola frontale da 200mm.



↔  
Le cover anteriori ed il filtro antipolvere.  
↔ ↔

↔

I copri bay anteriori sono forati per favorire lo scambio termico con l'esterno e dispongono tutti di un filtro antipolvere.

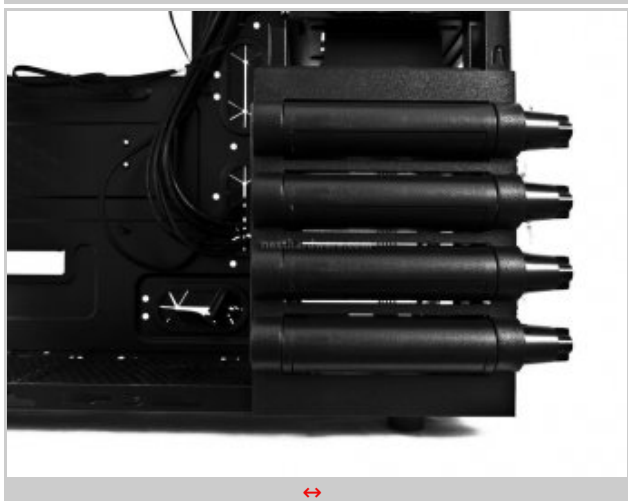
↔

↔

## 6. Caratteristiche interne

### 6. Caratteristiche interne

↔



↔

Il sistema di fissaggio dei drive da 5.25 pollici è gestito da un sistema a perni in acciaio, posizionati su un profilo in plastica facilmente rimovibile/inseribile ruotando una manopola con inciso il simbolo



di Thermaltake.

Poco più in basso è presente una predisposizione per un card reader o una docking station come, per esempio, l'[Extreme Speed 3.0](http://www.thermaltake-italia.it/item.php?codice=AC0018&descriz=Extreme+Speed+3.0) (<http://www.thermaltake-italia.it/item.php?codice=AC0018&descriz=Extreme+Speed+3.0>), ed un alloggiamento supplementare per un SSD.

Continuando a scendere troviamo il cestello che consente una configurazione hot-swap del nostro sistema, dentro al quale sono presenti le slitte per un rapido inserimento dei drive.



↔

Le slitte sono realizzate in solida plastica e permettono l'installazione di drive da 2.5 e 3.5 pollici non in modalità tool-less, ma tramite l'uso delle viti fornite in bundle.



↔

La parte interna del cestello consente, inoltre, di installare una ventola opzionale per aiutare la

poderosa ventola frontale nell'immissione di aria verso la parte bassa della scheda madre.

↔



Dettagli del sistema hot-swap e del pannello frontale delle connessioni.

↔

Per migliorare il cable management Thermaltake ha deciso di usare un singolo cavo per l'alimentazione del sistema hot-swap.

---





↔

Nelle immagini soprastanti possiamo vedere, da sinistra verso destra, la ventola da 120mm che gestisce i flussi d'aria in estrazione, i bracket PCI e l'alloggiamento per l'alimentatore.

↔

## 7. Sistema di Raffreddamento

### 7. Sistema di raffreddamento

↔

Ad occuparsi del sistema di raffreddamento del Thermaltake Level 10 GTS↔ sono due ventole, una per immettere aria fresca, situata nella parte frontale, ed una per estrarre l'aria calda↔, posizionata nella parte posteriore.↔

### Disposizione ventola frontale in immissione



↔

### Caratteristiche Tecniche

↔ Produttore	Thermaltake (Taiwan)
↔ Modello	AF0046↔
↔ Dimensioni	200 x 200 x 20mm
↔ Colore	Trasparente
↔ Led	Blu
↔ Tensione	12V
↔ Corrente	0.2Amp
↔ Potenza	2.4W +/- 10%
↔ Rumorosità	28.8dB(A)

↔ Regime di Rotazione	800RPM +/- 20%
↔ Pressione Statica	0.175 mm H2O
↔ Flusso d'aria	65.3 CFM
↔ MTBF	30.000h

↔

### Disposizione ventola posteriore in estrazione

Posizionamento	Immagini
	
	

↔

### Caratteristiche Tecniche

↔ Produttore	Thermaltake (Taiwan)
↔ Modello	AF0024↔
↔ Dimensioni	120 x 120 x 25mm
↔ Colore	Nero
↔ Led	Assenti
↔ Tensione	12V
↔ Corrente	0.38Amp
↔ Potenza	4.56W +/- 10%
↔ Rumorosità	29.5dB(A)
↔ Regime di Rotazione	1800RPM +/- 10%
↔ Pressione Statica	1.157 mm H2O
↔ Flusso d'aria	64.286 CFM
↔ MTBF	80.000h

↔

### Disposizione ventole opzionali

↔

### Soluzione A - Un migliore ricircolo d'aria - Rumorosità Contenuta

Posizionamento	Immagini
----------------	----------



↔

### Soluzione B - Massima personalizzazione delle ventole - Media Rumorosità



↔

### Caratteristiche Tecniche

↔ Produttore	Thermaltake (Taiwan)
↔ Modello	AF0018↔
↔ Dimensioni	120 x 120 x 25mm
↔ Colore	Nero e Bianco
↔ Led	Assenti
↔ Tensione	12V
↔ Corrente	0.10-0.33Amp
↔ Potenza	1.20-3.96W +/- 10%
↔ Rumorosità	16dB(A)
↔ Regime di Rotazione	800-1300RPM +/- 10%
↔ Pressione Statica	1.42 mm H2O
↔ Flusso d'aria	58.3 CFM
↔ MTBF	50.000h

↔

Thermaltake ha deciso di lasciare ampia libertà di personalizzazione del sistema di raffreddamento ai propri utenti, posizionando due sole ventole sufficienti per gestire i flussi d'aria in caso si installi una configurazione di fascia media.

Ogni possessore del Level 10 GTS potrà scegliere, quindi, se installare due ventole da 200mm e

avere un buon compromesso tra prestazioni e rumorosità , oppure se aggiungere ben quattro ventole da 120mm puntando solo alla massima capacità di raffreddamento ottenibile.

↔

## 8. Montaggio Componenti

### 8. Montaggio Componenti

↔



↔

Per accompagnare il Thermaltake Level 10 GTS↔ ↔ nella sua fase di assemblaggio, abbiamo deciso di utilizzare un sistema a liquido sigillato, modello Bigwater A80, ed un alimentatore della serie TR2 da 700W.

Il [Thermaltake Bigwater A80](http://www.thermaltake-italia.it/item.php?codice=CLW0214&descriz=Bigwater+A80) (<http://www.thermaltake-italia.it/item.php?codice=CLW0214&descriz=Bigwater+A80>) è un sistema di raffreddamento All-in-One composto da un radiatore monoventola in alluminio a singola fila di tubi piatti raffreddato da una ventola VR con relativo controller, uno scambiatore di calore per CPU con base in rame e pompa incorporata ed è caratterizzato dalla presenza di un sistema di ritenzione compatibile con tutti i più recenti socket AMD ed Intel, compreso il nuovo LGA 2011.

↔

---



↔

Una volta smontato il case e arrivati alla sola struttura di base cominciamo con la fase di assemblaggio.

Per prima cosa andiamo a montare la scheda madre e l'alimentatore che inseriremo con la ventola rivolta verso il basso.

A questo punto procediamo alla rimozione della ventola posteriore per assemblare il nostro sistema a liquido per poi passare all'installazione della nostra unità di storage e del masterizzatore, e riposizioniamo il frontale del case.

Completiamo poi l'operazione installando la scheda video, le ram ed i dischi sulle slitte hot-swap dedicate.

↔

---



Dettaglio della ventola frontale, modello AF0046, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nella pagina precedente.

La ventola da 200mm, posizionata sul frontale del case, dispone di un sistema di illuminazione a LED di colore blu che sottolinea ulteriormente la natura gaming del prodotto.

↔



↔



↔



↔



↔

↔

In pochi minuti abbiamo finito di assemblare il nostro↔ Level 10 GTS con un risultato finale di ottimo livello.

↔

↔



## 9. Conclusioni

### 9. Conclusioni

↔

Il Thermaltake Level 10 GTS conserva il design le caratteristiche principali del modello GT nonostante le dimensioni ridotte, perdendo sì la possibilità di installare al proprio interno schede madri in formato E-ATX, ma riuscendo ad offrire uno spazio di ben 315mm, ad esempio, sufficiente per l'installazione delle ultime VGA top di gamma di casa NVIDIA e AMD.

Nonostante i diversi materiali utilizzati, plastica per il frontale e solido acciaio per la struttura ed i pannelli, l'effetto finale è uniforme e convincente.

La verniciatura, di colore nero opaco, è stata realizzata a fuoco, ma risulta omogenea e resistente ai graffi.

Il pannello delle connessioni, posto sul lato destro della parte frontale, risulta completo e, grazie alla presenza di un cavo USB SuperSpeed con plug a 20 pin, consente di collegare le due porte USB 3.0 direttamente all'header della scheda madre.

I filtri antipolvere, come consuetudine Thermaltake, sono facilmente rimovibili e lavabili sotto acqua corrente.

Il sistema di raffreddamento è gestito da due ventole, di cui una frontale da 200mm dotata di LED blu ed una posteriore da 120mm, una configurazione sufficiente per un sistema di media potenza, ma comunque migliorabile, all'occorrenza, grazie alla numerose predisposizioni esistenti.

Il prezzo su strada di questo nuovo Mid Tower è di circa 90 euro, a nostro avviso pienamente in linea con la qualità e le caratteristiche espresse.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, assegniamo al Thermaltake Level 10 GTS il nostro voto più alto.

↔

***Si ringrazia Thermaltake Italia per l'invio del sample oggetto della nostra recensione.***

↔

↔



nexthardware.com